

亚洲智能芯片展-2024年智能芯片展会

产品名称	亚洲智能芯片展-2024年智能芯片展会
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

随着中国对投资经营环境的重视和不断改善，我国芯片产业发展迅速，政策环境优良，为行业发展提供了有力支撑，“中国芯”正在迅速崛起，预计2024年芯片市场规模将突破千亿元。正如国务院副总理刘鹤所强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，同时必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用。工业和信息化部副部长辛国斌则强调，将重点支持企业发挥引领作用，加快qiche芯片等技术攻关和产业化应用。国资委主任张玉卓也明确表示，将加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入。

2024第六届SEMI-e 深圳国际半导体技术暨应用展览会以“芯中有算，智享未来”为主题，守正创新向上进阶。展示内容更为丰富，活动体验更加多元精彩，同时将聚合国际化资源，开设“3馆14区”，展会规模超60,000m²，预计将迎来800+企业盛装亮相，展品覆盖芯片设计、晶圆制造与封装、新型显示Mini/Micro-LED、半导体专用设备、第三代半导体、电子元器件、机器视觉与传感器等全产业链，预计吸引60,000+观众到场参观。除此之外，展会同期将结合行业热点推出主题活动40+，邀请近百位行业院士、企业代表、业界大咖专题jiema行业前沿科技与思维，加速科研成果转换应用落地，全方位多角度推动中国半导体产业高质量发展。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

- 4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等
- 5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等
- 6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等
- 7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等
- 8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等
- 9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等
- 10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等qiche雷达传感器上下游供应链各环节产品等
- 11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等
- 12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等
- 13、qiche半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、qiche电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

2024年半导体展会为企业树立品牌形象，促进贸易合作、市场开发，引领行业趋势，以发展的眼光挖掘未来电子市场的新需求，创新展会内涵，全方位、多层次组织观众，为参展企业和参会客商提供了一个技术交流、产品展示和贸易洽谈的平台。

以实际行动助力行业企业高质量发展，从商贸对接、新品发布、行业热点聚焦、创新技术交流等方面，集中展示智能信息化时代下半导体产业的新成果及趋势，全方位呈现当前半导体行业丰富多彩的面貌和蓬勃发展的生态。

工业和信息化部副部长辛国斌则强调，将重点支持企业发挥引领作用，加快qiche芯片等技术攻关和产业化应用。国资委主任张玉卓也明确表示，将加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入。